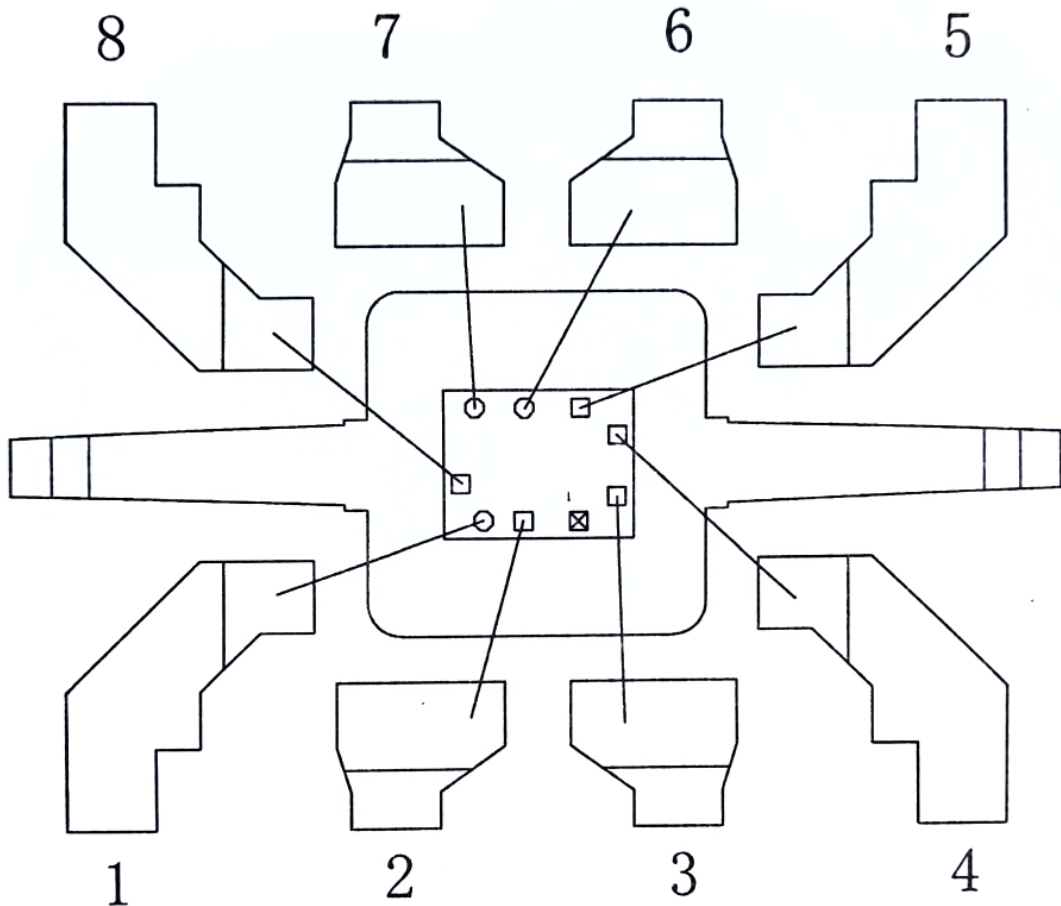
 池州华宇电子科技股份有限公司 CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD				客户代码 Customer No	008	线号 Drawing No.	HY-PX-008-800 A	
焊线图纸 Bonding Diagram				产品名称 Product Type	HS0810		封装外型 PKG Type	SOP8L
焊线种类 Wire Type	焊线直径(um) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(um) Total wire length	最长线长(um) Longest wire length	最短线长(um) Shortest wire length	型封料型号(绿色环保) Compound Type (Green)		LF 载体尺寸 LF Pad Size
合金丝 Ag	20	8	9741	1087	896	首选(Preferred): EMG-600-2 备选(Optional): EMB-G630AY		SOP8L-PR (60*60mil) (1524*1524um ²)
客户图号 Customer drawing NO.								



框架传送方向(照片): L/F Direction (D/A): 椭圆孔	实物图: Chip photo:	特殊说明 Special Instructions: DB注意: 芯片居中放置; WB注意: 数字为不打焊pad点个数. 不管控三个八边形pad裂纹 HY-PX-008-800 A由HY-PX-008-302 A升级, 添加 WB备注
---	---------------------	--

说明 Instruction	贴片胶类型 Epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size (um ²)	最小焊盘尺寸 Min BPO (um ²)	最小焊盘间距 Min BPP(um)	锡垫厚度(um) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	贴片通孔直径 Street line (um)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否过 Is over	晶圆厚度 Wafer Thickness
A芯: DIE A	导电胶 (conducivity) S210	HS0810	855-655(um ²) 33.66*25.79(mil ²)	80*80	179	1.2	是/Yes	80	6	否/NO	300
B芯: DIE B											
C芯: DIE C											
编制 Prepared by	日期日期 Create Date		2024/9/23		生效日期 Effective Date				客户确认签字: 池州 Customer Signature		
研发审核 R&D Check	产品工程审核 PE Check				批准 Approved by				2024.9.24		

温馨提示: 图纸为产品下机生产的唯一依据, 请认真核对, 我司依据您提供的图纸生产, 如因提供不全产生不可修复损失, 谢谢!
Warm tips: the drawing is the only basis for the production of the product. Please confirm it carefully. Our company will produce the drawings according to the drawings you have signed back, such as
drawing mistakes, which will produce incalculable loss. Thank you